ANMELDUNG für die Ausstellung:

☐ Ja, wir möchten unsere Produkte auf der begleitenden Ausstellung zur IMAPS-Konferenz 2010 an der Hochschule München präsentieren.

☐ Ja, wir möchten unsere Werbeseiten auf den CD-ROM-Proceedings der IMAPS-Konferenz präsentieren.

Mit den umseitig abgedruckten Bedingungen sind wir einverstanden.

Bitte senden Sie uns die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung zu.

Firma.....: _____

Ansprechp.: _____

Straße.....: _____

Ort.....: _____

Telefon.....: _____

Fax/Email: _____

IMAPS-Deutschland e.V.
Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
c/o Fraunhofer-Institut für
Mikrointegration (IZM)
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin

Fax:+49 (0) 30-46403-271, Email: martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Wegbeschreibung:

Die Parksituation ist schwierig.

Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

Um vom Hauptbahnhof in das Hauptgebäude R
in der Lothstraße 64 zu kommen,
nehmen Sie die Tram Linie 20/21
in Richtung Moosach/Westfriedhof.
Von der Haltestelle Lothstraße geht es
in Richtung Osten etwa 200 Meter
entlang der Lothstraße.
Das Hauptgebäude R
befindet sich dann auf der rechten Seite.

Anfahrtsskizze unter

www.hm.edu

Deutsche IMAPS-Konferenz 2010

Termin:
Dienstag/Mittwoch
12. - 13. Oktober 2010

Veranstaltungsort:
Hochschule München
Lothstraße 64
D-80335 München
Hauptgebäude R

P R O G R A M M

Dienstag, 12. Oktober 2010

12:00	Einschreibung	
13:00	Konferenzeröffnung	Vorsitzender IMAPS-Deutschland
13:10	LTCC im Verbund mit keramischen und metallischen Materialien	Josef Leschik FH-Landshut
13:35	Passive Integration für LTCC-Mikrowellen-Module- Technologie- und Designoptimierung	Ruben Perrone MSE Berg
14:00	Vergleich der keramischen Multilayer-Technologien HTCC und LTCC für die RF Integration	Franz Bechtold Via electronic Hermsdorf, Schott Landshut
14:25	Multikomponenten-LTCC bestehend aus niedrig-sinternden X8R Kondensatorfolien, niedig-sinternden Ferritfolien und Standard-Basisfolien	Hamid Naghibzadeh BAM Berlin
14:50	Aussteller stellen sich kurz vor (je 2 min)	
15.20	Kaffeepause	
16:00	Kleben von Chips auf RFID-Transponder mittels eines vorapplizierten Klebstoffs auf Waferebene	Jana Kolbe IFAM Bremen
16:25	Inkjetdruck von Nanopartikeln- ein kontaktloses Verfahren zur Strukturierung elektronischer Baugruppen	Werner Jillek Ohm Hochschule Nürnberg
16:50	Leitstrukturen auf Polymerkathetern für die MRT-Bildgebung	Andreas Brose Universität Magdeburg
17:15	Ende der Vorträge	
17:20	**Mitgliederversammlung**	
19:30	**Geselliger Abend beim Augustiner**	

Internet: **http://www.imaps.de**

Teilnehmergebühren:
€ 130,-- IMAPS-Mitglieder
€ 210,-- Nichtmitglieder
€ 30,-- Studenten

Die Bezahlung der Teilnehmergebühr ist nur **bar** möglich. In der Teilnehmergebühr sind die Proceedings auf CD, Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung in den Augustiner-Gaststätten enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Einschreibung:

Eine vorherige Anmeldung ist nicht vorgesehen!

Die Einschreibung erfolgt direkt in der Tagungsstätte an der Hochschule München. Für den Nachweis der Mitgliedschaft in der IMAPS-Deutschland bringen Sie bitte den Mitgliedsausweis 2009 mit. Nur so ist eine Einschreibung zum Mitgliederpreis möglich!

Hotelreservierung: **Fremdenverkehrsamt München**
Telefon: +49(0)89 / 233 03 00
Fax: +49(0)89 / 233 30 233
email: tourismus@muenchen.btl.de

P R O G R A M M

Mittwoch, 13. Oktober 2010

09:00	Neue Verfahren der Plasmareinigung	Reinhard Windemuth Panasonic Haar
09:25	Thermische Behandlung edelmetallhaltiger Produktionsrückstände als Vorstufe zur Edelmetallrückgewinnung	Gebhard Schetter Ruppmann Verbrennungsanlagen Stuttgart; Recom Aschaffenburg
09:50	Electrostatic Discharge (ESD), Quelle, Fehlermechanismen in einer SMT-Linie und Lösungen	Hartmut Berndt Bestat, Kesselsdorf bei Dresden
10:15	MST-basiertes Lebensdauermonitoring bei photovoltaischen Modulen	Sabine Nieland CiS Erfurt
10:40	Kaffeepause	
11:20	Fineline-Strukturierung auf LTCC-Substraten für HF-Komponenten	Dirk Stöpel TU Ilmenau
11:45	Oberflächenhydrophobierung und deren Anwendung für die Mikrosystemtechnik	Tanja Braun FhG IZM Berlin
12:10	Generative Herstelltechnologien im Mikro- und Nanobereich	Frank Ansorge FhG IZM-MMZ Oberpfaffenhofen
12:35	Technologien der Systemintegration - optoelektronisches Packaging	Erik Beckert IOF Jena
13:40	Mittagspause	
14:05	Hermetischer Schutz von ungehäusten Chips mittels Borsilikatglas als Dünnschichtpassivierung	Jürgen Leib MSG Lithoglas AG Berlin
14:30	Energieautarke hochverschleißfeste Dünnschichtsensoren für Anwendungen im Maschinenbau	Saskia Biehl IST Braunschweig
14:55	Energieautarker Drucksensor für automotive Anwendungen	Martin Kurth A.Raymond GmbH & Co.KG Lörrach
15:20	Silbersintern bei niedrigen Temperaturen und Drucken mit mikroskaligen Silberpulvern für die Aufbau- und Verbindungstechnik	Thomas Krebs Heraeus Hanau
15:45	Schlussworte	Vorsitzender IMAPS-Deutschland
16:00	Ende der Veranstaltung	

Hinweis auf weitere Veranstaltungen:
Stuttgart IMAPS- Seminar im Winter/ Frühjahr 2011
Dresden 19./20.10. 2010 Advanced Packaging Conference bei SEMICON Europe 2010
Raleigh 31.10./4.11.2010 43th Symposium on Microelectronics IMAPS NA

Begleitende Ausstellung zur Konferenz:

Nach den positiven Resonanzen auf den letzten Veranstaltungen möchten wir auch diesmal allen interessierten Firmen die Möglichkeit geben, auf kleinen Ständen parallel zur Vortragsveranstaltung ihre Produkte (kleine Geräte, Muster, Dokumentationen) zu präsentieren.

Standgröße und -ausstattung:
- ca: 6 m²
- Tisch (ca: 120 cm x 80 cm)
- Pinwand (ca: 120 cm x 120 cm)
- 2 Stühle
- 230V-Anschluß

Preis: € 675,--

Beinhaltet zusätzlich zum Stand auch für 2 Personen die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung. Eingeschlossen sind weiterhin die Leistungen für die Werbung auf CD-ROM. Bitte beachten Sie den Termin für den Eingang der Daten.

Informationen und Reservierung:

Wenn Sie noch Fragen zur begleitenden Ausstellung haben, so wenden Sie sich bitte an:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
Tel.: +49-(0) 30-46403-172 oder -270 Sekr.
Fax: +49-(0) 30-46403-271
Email:martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Anmeldungen zur Ausstellung können Sie ab sofort mit dem umseitigen Formular durchführen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

Werbung auf CD:

Die Proceedings der IMAPS-Konferenz erscheinen auf CD-ROM. Wir bieten Ihnen an, dort Ihre Werbeseiten zu präsentieren. Dazu benötigen wir von Ihnen die Dateiformate Acrobat(.pdf), CorelDraw (.cdr) oder alle Windows-Office-Formate (z.B. .doc, .ppt) per e-mail **bis zum 10.9.2010**.

Preis: € 120,-- für eine A4-Seite
(jede weitere Seite: € 60,--)

Im Preis ist auch ein Link auf Ihre Internetseite unter http://www.imaps.de für 1 Jahr enthalten.

Informationen und Reservierung für die Werbung auf CD: Dr.-Ing. Gisela Dittmar
Tel.: +49 (0) 7361 931 129
Fax: +49 (0) 7361 943 004
email: gisela.dittmar@imaps.de